

《电子产品装配与检测技术》

图书基本信息

书名：《电子产品装配与检测技术》

13位ISBN编号：9787504575128

10位ISBN编号：7504575127

出版时间：2009-3

页数：237

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《电子产品装配与检测技术》

内容概要

《电子产品装配与检测技术》为国家级职业教育规划教材。《电子产品装配与检测技术》根据高等职业院校教学实际，由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。《电子产品装配与检测技术》以厦华XT-5680R彩色电视机为载体，以该机元器件装配-整机装配、调试-整机检验、包装的完整工艺过程为脉络，组织编写电子产品装配与检测的教学内容，强化训练学生的工艺分析与制订、程序编制的能力。全书共分为5个模块，包括：整机装配常用元器件的识别与检测、印制电路板的装配与焊接、整机装配与调试、整机检验与包装和电子产品装配新技术。每个课题都配有详细的操作步骤和图示，以激发学生学习兴趣，提高教学效果。每模块后有思考与练习题，以复习和巩固。

《电子产品装配与检测技术》可作为高等职业院校应用电子技术专业教材，也可作为本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校的应用电子技术专业教材，或作为电子产品装配与检测操作人员的参考书、自学用书。

《电子产品装配与检测技术》由李长军主编，关开芹、肖云、沈东辉、吴清红、姜修兰、袁桂萍、李长成、王公安、薛喜香参编，朱照红主审。

《电子产品装配与检测技术》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com